

Согласовано

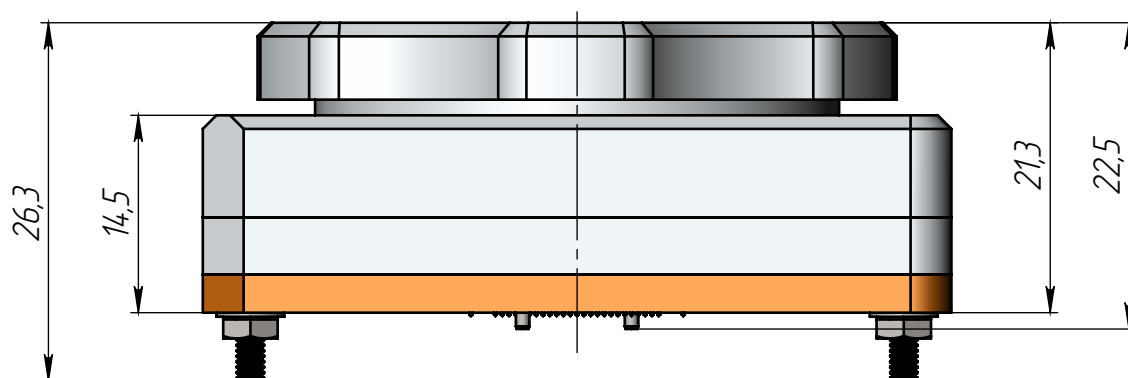
*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*

____/____2018г.

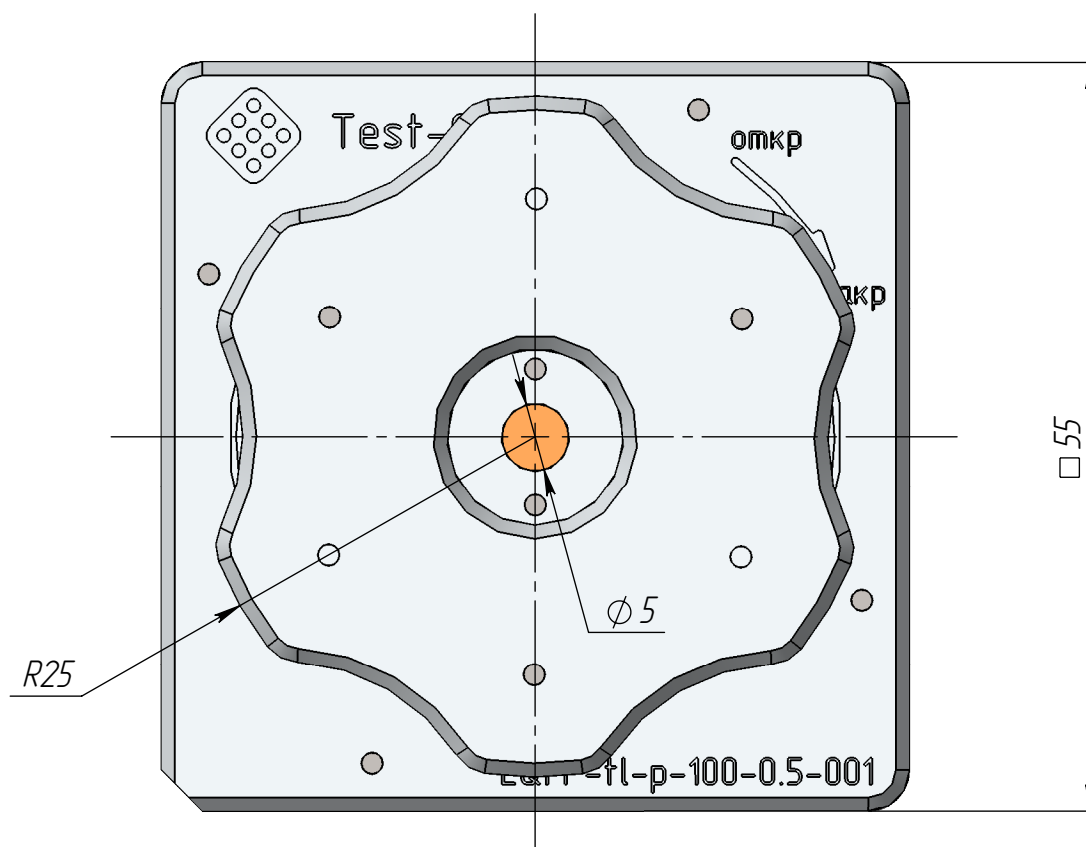
____/____2018г.

*Паспорт контактирующего устройства
LQFP-tl-p-100-0.5-001*

Внешний вид и габаритные размеры КУ

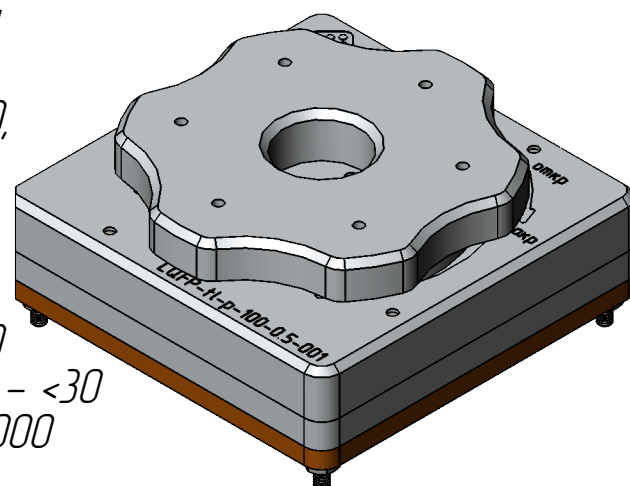


- × Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами М2 (без пайки). Число мест крепления – 4.
- × Базирование КУ относительно платы осуществляется штифтами $\phi 1$ мм. Количество штифтов – 2 шт.

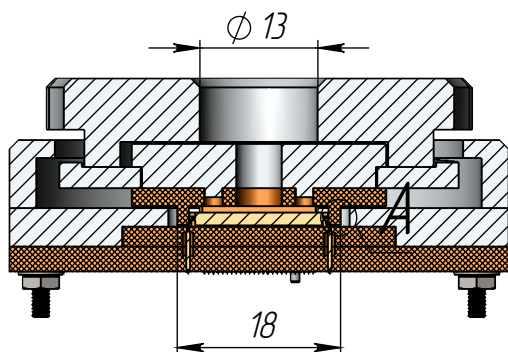


- × Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
- × Количество выводов КУ, шт. – 100
- × Материал КУ (торговая марка) – PEI UL TEM 1000, алюминий

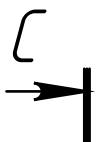
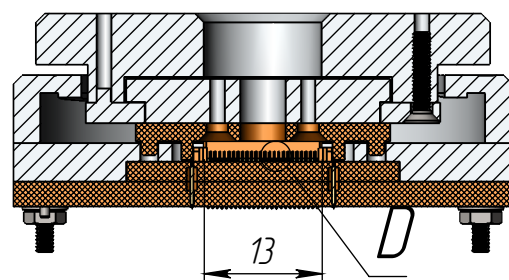
- × Материал коннекторов – ВеСи
- × Покрытие коннекторов – Au
- × Диапазон рабочих температур, °C –55...+150
- × Максимальный ток на один контакт (НУ), А – 1,0
- × Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30
- × Гарантированное кол-во контактирований – 10000
- × Ширина полосы, ГГц@ – 3 дБ – >1



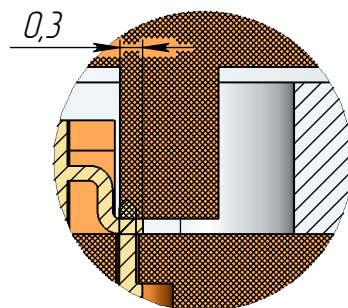
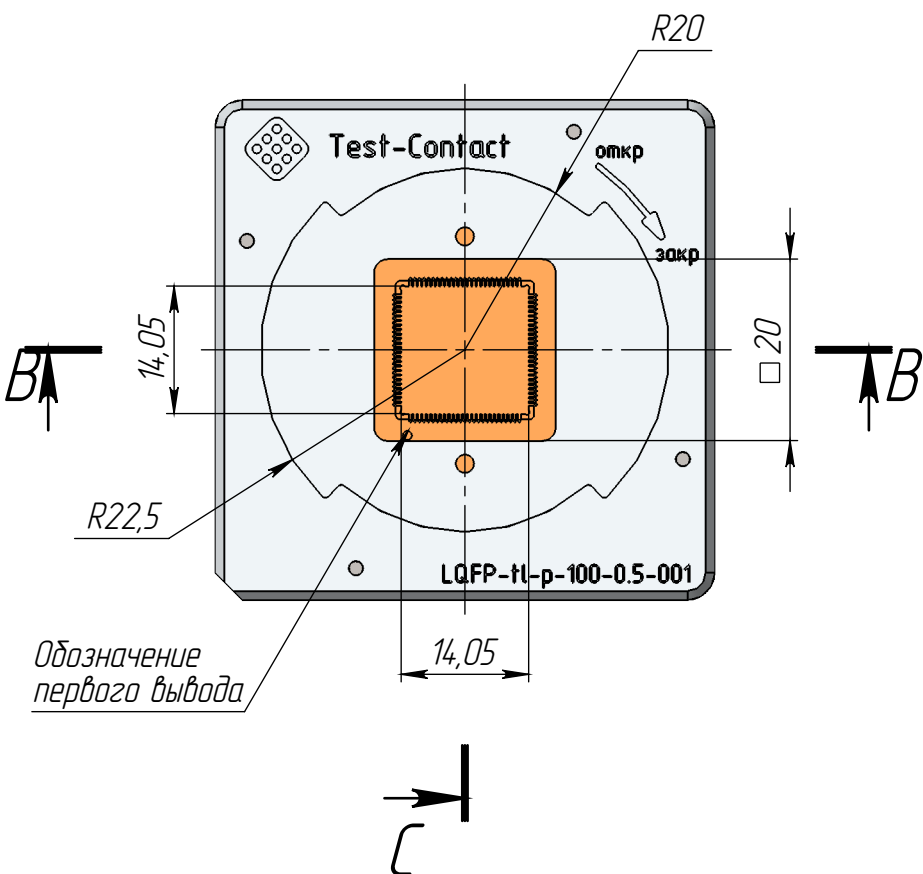
B-B



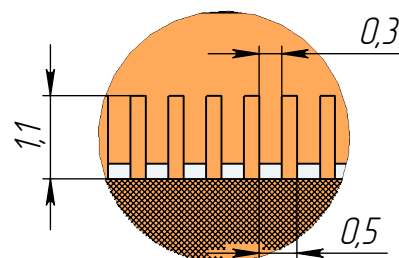
C-C



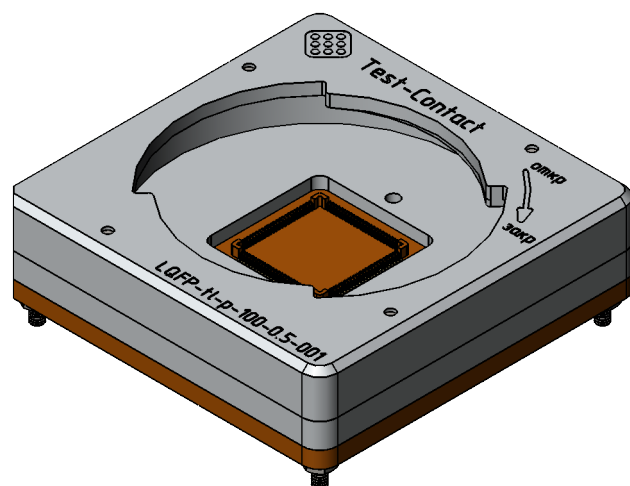
A (10 : 1)



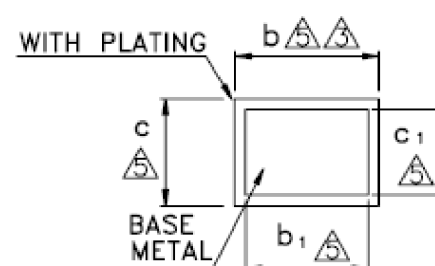
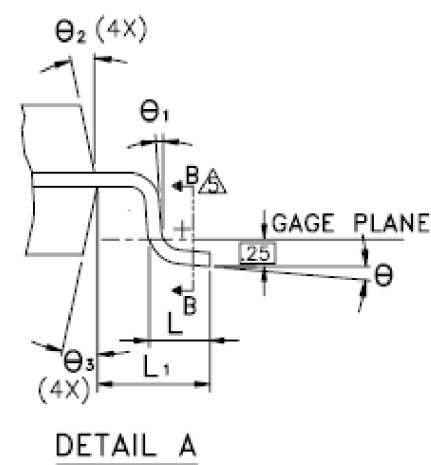
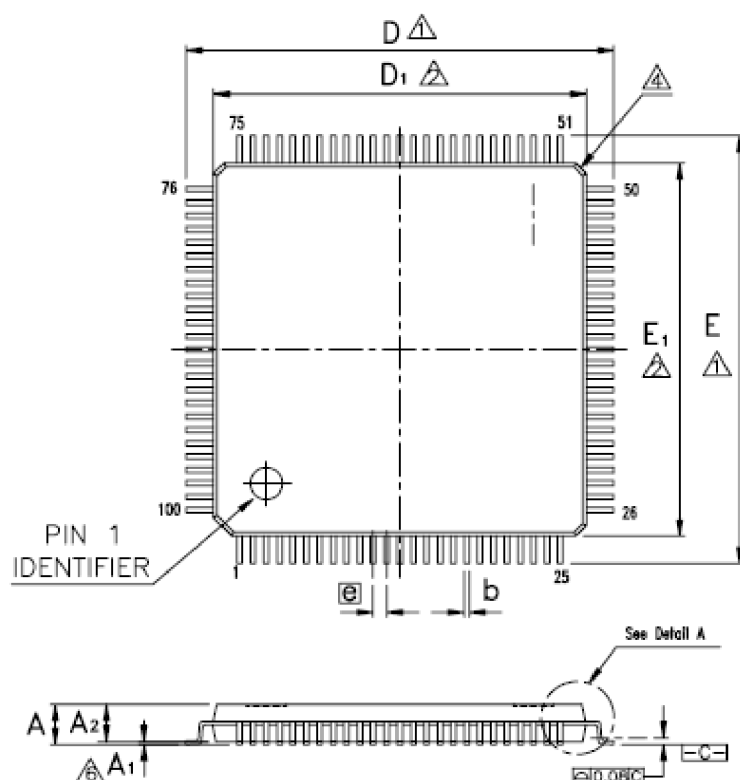
D (10 : 1)



1. *-Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-МК.



Внешний вид и габариты ЭРИ
(предоставляется заказчиком)



SECTION B-B

Notes:

1. To be determined at seating plane -c-
2. Dimensions D1 and E1 do not include mold protrusion.
D1 and E1 are maximum plastic body size dimensions including mold mismatch.
3. Dimension b does not include dambar protrusion.
Dambar can not be located on the lower radius of the foot.
4. Exact shape of each corner is optional.
5. These dimensions apply to the flat section of the lead between 0.10 mm and 0.25 mm from the lead tip.
6. A1 is defined as the distance from the seating plane to the lowest point of the package body.
7. Controlling dimension: millimeter.
8. Reference document: JEDEC MS-026, BED.

Symbol	Dimension in inch			Dimension in mm		
	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
A	-	-	0.067	-	-	1.70
A1	0.000	0.004	0.008	0.00	0.1	0.20
A2	0.051	0.055	0.059	1.30	1.40	1.50
b	0.006	0.009	0.011	0.15	0.22	0.29
b1	0.006	0.008	0.010	0.15	0.20	0.25
c	0.004	-	0.008	0.09	-	0.20
c1	0.004	-	0.006	0.09	-	0.16
D	0.630 BSC			16.00 BSC		
D1	0.551 BSC			14.00 BSC		
E	0.630 BSC			16.00 BSC		
E1	0.551 BSC			14.00 BSC		
e	0.020 BSC			0.50 BSC		
L	0.016	0.024	0.031	0.40	0.60	0.80
L1	0.039 REF			1.00 REF		
θ	0°	3.5°	9°	0°	3.5°	9°
θ1	0°	-	-	0°	-	-
θ2	12°TYP			12°TYP		
θ3	12°TYP			12°TYP		

TITLE: 100LD LQFP (14x14x1.4mm)			
PACKAGE OUTLINE DRAWING, FOOTPRINT 2.0mm			
LEADFRAME MATERIAL:			
APPROVE		DOC. NO.	
		VERSION	1
		PAGE	OF
CHECK		DWG NO.	LQ100 - P1
		DATE	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP.			

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;*
- производить установку КУ после просушки ПП.*

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне*

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.*

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.